

CuNiP

Composition chimique indicative

Cu :	> 98,8 %
Ni :	0,3 %
P :	0.02 %

Applications typiques

Electronique et Electrique : Supports de semi-conducteurs

CARACTERISTIQUES MECANIQUES

Etat H :		H 040	H 065	H 090	H 110
Dureté	HV	45-65	65-95	90-110	≥ 110

Etat R :		R 220	R 240	R 290	R 360
Résistance à la traction	Rm (MPa)	220-260	240-300	290-360	≥ 360
Limite d'élasticité (1)	Rp 0,2 (MPa)	≤ 140	≥ 180	≥ 250	≥ 320
Allongement	A50 (%)	≥ 33	≥ 8	≥ 4	≥ 2

RAYON DE PLIAGE SUIVANT EPAISSEUR ASSOCIEES AUX ETATS DE LIVRAISON CI-DESSUS

Rayon de Pliage (2)	90°⊥ au sens de laminage	0 × e	0 × e	0 × e	(3)
	90° // au sens de laminage	0 × e	0 × e	0,5 × e	(3)

CARACTERISTIQUES MECANIQUES suivant ancien catalogue GRISET

Normes NF		0	H 11	H 12	H 13	H 14,1	H 14,2
Dureté	HV	50-65	65-90	95-115	100-125	115-130	≥ 120
Résistance à la traction	Rm (MPa)	230-280	240-300	280-350	310-390	350-430	≥ 380
Limite d'élasticité	Rp 0,2 (MPa)	≤ 160	≥ 140	≥ 260	≥ 280	≥ 340	≥ 360
Allongement	A50 (%)	30	25	12	5	2	-
Rayon de Pliage (2)	90°⊥ au sens de laminage	0 × e	0 × e	0 × e	0 × e	0,5 × e	(3)
	90° // au sens de laminage	0 × e	0 × e	0 × e	0,5 × e	1 × e	(3)

CARACTERISTIQUES PHYSIQUES (à 20°C) (4)

Masse Volumique (Kg/dm3)	Conductivité électrique (% IA CS)	Résistivité électrique (μΩ,cm)	Conductivité thermique (W/m,K)	Module d'élasticité (kN/nm ²)	Coefficient de dilatation thermique (10-6/K)	Température de fusion (°C)	Module de cisaillement (kN/mm ²)
8,9	> 80	< 2,1	330	128	18	1060-1080	45

(1) Pour épaisseurs < 2 mm

(2) Rayon de pliage exprimé en fonction de l'épaisseur (e) du laminé

(3) Pliage possible à définir avec Griset

(4) Valeurs données pour un état recuit

Ce document a été rédigé à titre informatif et les valeurs contenues sont indicatives. Notre responsabilité ne peut-être engagée sans qu'une revue de contrat formalisée ne soit effectuée avec notre société. Nos services commerciaux et techniques sont à votre disposition pour étudier la bonne correspondance de vos besoins avec les bonnes propriétés physico-mécaniques de nos matériaux.